

## チューコーフロー™ 銅張積層板

## CH2868D

## 製品概要

ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを積層した銅張積層板です。銅箔との密着性が良好でミリ波帯域での伝送損失が極めて小さく、プロファイルフリー銅箔使用時の引き剥がし強度が高い製品です。

## 特長

- ・ミリ波帯域での伝送損失が極めて小さい。
- ・優れた高周波特性。
- ・ドライプロセス等に適応可能。

## 用途例

- ・車載用レーダー
- ・衝突防止用レーダー
- ・高度道路交通システム 等

## 製品規格

製品番号	製品寸法 (mm)	寸法公差 (mm)	製品厚み (mm)	厚み公差 (mm)
CH2868D	460 W × 610 L	+5, -0 × +5, -0	0.135	±0.015
			0.245	±0.020

※製品厚み及び公差の数値は銅箔を含みます。

## 製品性能

試験項目	単位	CH2868D (厚み：0.245mm)	CGP-500 (厚み：0.33mm)	試験条件
伝送損失	dB/mm	0.056	0.09～0.10	CPW伝送損失 76GHz

試験項目	単位	測定値	試験条件
比誘電率	-	2.28	円板共振法 (Z軸) 12GHz
誘電正接	-	0.0015	円板共振法 (Z軸) 12GHz
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$	$5 \times 10^{16}$	A
		$1 \times 10^{16}$	C-96/40/90
表面抵抗率	$\Omega$	$6 \times 10^{16}$	A
		$4 \times 10^{12}$	C-96/40/90
絶縁抵抗	$\Omega$	$1 \times 10^{15}$	A
		$1 \times 10^{14}$	D-2/100
吸水率	%	0.005	E-24/50+D-24/23
線膨張係数	ppm/°C	X 20	-65°C～150°C
		Y 20	
		Z 69	
比重	-	2.2	A
引きはがし強さ	kN/m	1.2	A
燃焼性	-	不燃	-

※試験に使用した基板は、厚み $t=0.245\text{mm}$ (銅箔厚み $12\mu\text{m}$ )を使用。  
 ※CGP-500はチューコーフロー™ 銅張積層板のスタンダード品です。  
 ※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

## 中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052	東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052	東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003	大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074	福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バインビル5階	092-724-1411

お問い合わせ：support@chukoh.co.jp



## 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。